

中信建投证券股份有限公司
关于合肥顾中科技股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：合肥顾中科技股份有限公司
保荐代表人姓名：吴建航	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号北塔 2203 室
保荐代表人姓名：廖小龙	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号北塔 2203 室

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕415 号文”批准，合肥顾中科技股份有限公司（以下简称“顾中科技”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股 200,000,000 股。公司本次发行新股的发行价为 12.10 元/股，募集资金总额人民币 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 187,373,816.76 元后，募集资金净额人民币 2,232,626,183.24 元。本次公开发行股票于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。

经中国证监会“证监许可〔2025〕2298 号文”批准，公司向不特定对象发行 8,500,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 838,790,094.34 元。本次发行证券于 2025 年 11 月 21 日在上海证券交易所上市。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）担任顾中科技首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本 2026 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	保荐机构、保荐代表人应当协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和本规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。	保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
2	保荐机构、保荐代表人应当持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 保荐机构、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。 保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。 保荐机构已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
3	上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、本规则以及本所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
4	保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
5	保荐机构、保荐代表人应当持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。 保荐机构、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，保荐机构、保荐代表人应当发表意见予以说明。	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、查阅相关公开信息进行尽职调查等方式，了解顾中科技经营、股票交易等情况，对顾中科技开展持续督导工作。经核查，本持续督导期内，上市公司不存在持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项。
6	上市公司股票交易出现严重异常波动的，	本持续督导期间，上市公司及相关主体

	工作内容	持续督导情况
	保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司及时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。	未出现该等事项。
7	保荐机构、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐机构已督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
8	保荐机构、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。	保荐机构对上市公司募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并对上市公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现顾中科技存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）宏观经济和行业周期波动的风险

报告期内，国际贸易摩擦持续加剧，全球半导体供应链在地缘政治博弈与关税政策扰动下呈现区域化、碎片化趋势，行业整体仍处周期性波动区间，景气修复节奏分化明显。公司主营集成电路封装测试服务，与半导体行业景气度高度相关，呈现较强的周期性特征。从细分领域看，下游显示面板行业产能释放与需求波动并存，价格阶段性承压，间接对显示驱动芯片及配套封测需求造成扰动。同时，显示驱动芯片、电源管理芯片及射频前端芯片的主要终端应用集中于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、高清电视、智能穿戴及车载电子等领域。上述消费类电子产品具有技术迭代快、品牌与规格型号繁多、换机周期拉长等特点，导致终端需求变化较快、季节性波动显著，存在一定的不确定性。此外，AI 终端、智能汽车等新兴应用场景虽带来增量空间，但其对芯片性能与可靠性的更高要求，亦对公司工艺技术与交付能力提出了新的挑战。面对复杂的外部环境，公司将持续加强技术研发与市场开拓，优化产品结构，提升高附加值产品占比，增强抗周期波动能力，保障经营业绩的稳健性。

（二）技术及产品升级迭代的风险

随着全球集成电路行业持续发展及 AI 终端、智能汽车、超高清显示等新兴应用对芯片性能要求的不断提升，集成电路封装正向高密度、高带宽、低功耗、小型化方向加速演进，对端口密度、信号延迟及封装体积的管控要求日益严苛。以显示驱动芯片为例，一方面，随着 4K/8K 超高清显示、高刷新率及折叠屏等形态普及，屏幕分辨率与像素密度持续提升，I/O 数量显著增加，对凸块制造的引脚密度、微间距及测试复杂度提出更高要求，后段封装的精度控制与工艺难度亦大幅提升；另一方面，Mini LED、Micro LED 等新型显示技术正处于升级阶段，相关新型显示技术对已有显示技术的升级迭代将间接对显示驱动芯片封测技术产生一定影响。

如果公司无法根据行业发展趋势和下游客户需求进行技术与产品创新，或新开发的产品质量未能得到客户认可，或研发项目无法顺利实现商业化，将可能面临订单流失、市场地位下降的风险，从而对公司的核心竞争力造成不利影响。

（三）经营风险

1、行业波动及需求变化风险

受国际地缘政治冲突持续、全球宏观经济不确定性增加及下游终端需求分化等因素影响，近年来集成电路行业需求呈现较大波动。公司主营业务为集成电路封测综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、功率器件、射频前端芯片等多类产品，集成电路行业的发展状况对公司的生产经营具有重大直接影响。集成电路行业具有显著的周期性特征，且受宏观经济、贸易政策及下游应用迭代等多重因素叠加影响，其波动幅度往往超过全球经济整体波动幅度。2026 年以来，行业呈现 AI 相关领域量价齐升与传统消费电子赛道长期承压并存的 K 型分化格局，同时美伊冲突等地缘事件引发氦气供应紧张、能源成本上升等供应链扰动，进一步加大了行业运行的复杂性。若未来宏观经济形势变化、全球集成电路产业市场出现较大波动，或下游 AI 算力投入阶段性放缓、消费电子需求持续低迷，将对公司经营业绩带来较大影响。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，各大封测厂商积极布局先进封装业务，在显示驱动芯片封测领域，除细分行业龙头硕邦科技、南茂科技继续在相关领域保持领先地位外，综合类封测企业通过自建或与其他方合作等方式对相关领域也进行积极布局。相较于行业内头部封测企业，公司在资产规模、资本实力、产品服务范围等方面存在一定差距，面对行业竞争加剧的局面，若公司不能较好地采取措施应对，可能会对公司业务开拓以及经营业绩产生不利影响。

3、多元化芯片业务开拓不利的风险

公司从 2015 年开始布局铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等多元化先进封装技术的研发，并于 2019 年完成后段 DPS 封装的建置，目前正在建置载板覆晶封装、BGBM/FSM、Cu Clip 制程。报告期内，公司多元化芯片类业务虽增长较快但整体规模相对较小，非全制程占比较高，且主要集中在电源管理、射频前端等芯片领域，客户主要集中在中国境内，与长电科技、通富微电、华天科技等头部综合类封测企业相比综合实力具有较大差距。若综合类封测企业对相关细分领域进行大规模投入、多元化类客户导入不及预期或下游终端市场环境出现不利变化等情况，则存在多元化封测业务开拓不利的风险。

4、研发技术人才流失风险

集成电路封测行业是典型的技术密集行业，企业的技术研发实力源于对专业人才的储备和培养。虽然近几年中国大陆集成电路封测行业取得快速发展，从业人员逐步增多，但专业研发人才供不应求的情况依然普遍存在。由于近几年市场对于集成电路封测高端人才的需求急剧增加，人才招聘成本不断上升，未来一段时间，专业人才相对缺乏仍将成为制约行业发展的重要因素之一。若公司核心技术人才流失，将对公司的研发生产造成不利影响。

（四）财务风险

1、汇率波动风险

公司存在部分境外销售及境外采购的情况，并主要通过美元或日元进行结算。未来若人民币与美元或美元与日元汇率发生大幅波动，可能导致公司产生较大的汇兑损益，引起公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

2、存货跌价风险

报告期末，公司存货账面价值为 71,125.51 万元，占期末资产总额的比重为 9.12%。公司期末存货金额较大，占比较高，并且公司存货金额可能随着公司业务规模扩大进一步增长。如果未来市场需求、价格发生不利变动，公司将面临存货跌价的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。

3、商誉减值风险

2018 年 1 月，公司收购苏州硕中形成商誉 88,748.48 万元。报告期内，苏州硕中系公司封装测试业务主要经营主体，如果未来封装测试市场需求、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，而苏州硕中未能适应前述变化，则可能对苏州硕中的盈利能力产生不利影响，进而可能使公司面临商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

4、税收优惠存在不确定性的风险

报告期内，公司子公司苏州硕中享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率，若未来上述税收优惠政策发生变化或者子公司苏州硕中不再符合税收优惠条件，则可能对公司的经营业绩和盈利产生不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，硕中科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减（%）
营业收入	961,326,916.26	995,760,921.23	-3.46
利润总额	-303,825,384.46	112,740,099.95	-369.49
归属于上市公司股东的净利润	-303,449,852.90	99,191,402.40	-405.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,494,691.41	96,524,530.03	-130.56

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	7,139,950.38	234,190,993.63	-96.95
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年 12 月末	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,775,401,361.93	6,115,968,766.39	-5.57
总资产	7,799,209,090.92	8,001,256,841.71	-2.53

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	-0.26	0.08	-425.00
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.26	0.08	-425.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.02	0.08	-125.00
加权平均净资产收益率 (%)	-5.09	1.64	减少 6.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.49	1.59	减少 2.08 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	7.68	9.27	减少 1.59 个百分点

2026 年 1-6 月，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、报告期内，利润总额、扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润及对应每股收益、净资产收益率均减少，主要系公司全资子公司颀中科技（苏州）有限公司厂区凸块制程段发生火灾事故处置资产损失增加所致。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金等增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）技术研发优势

公司一贯坚持自主创新和精益求精的理念，始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。就显示驱动芯片封测业务而言，作为境内规模最大、进入时间最早的显示驱动芯片封测厂商之一，公司在“微细间距金凸块高可靠性制造”、“大尺寸高平坦化电镀”、“显示驱动芯片铜镍金凸块制造技术”等凸块制造技术以及“高精度高密度内引脚接合”、“125mm 大版面覆晶封装技术”、“高稳定性晶圆研磨切割技术”等后段封装技术方面积累了较多成功经验和技術成果，同时在高端设备技术改造、自动化系统方面具有较强实力，相关技术覆盖了整个生产制程，为公司产品保持较高竞争力提供了坚实保障。目前，公司已具备业内最先进 22nm 制程显示驱动芯片的封测量产能力。领先的技术优势及丰富的产品特点有助于公司在显示驱动芯片封测业务中保持较高的客户粘性和定价能力。

得益于公司在显示驱动芯片封测领域积累的丰富经验，公司在多元化类芯片封测领域的技术研发中也取得了阶段性成果，相继开发出铜镍金、铜柱、锡等金属凸块制造技术。其中，铜柱凸块可代替传统的打线封装，通过缩短连接电路的长度，以减小芯片封装面积和体积，从而克服芯片系统的寄生电容干扰、电阻发热和信号延迟等缺点；铜镍金凸块可通过重布线技术，在不改变前端芯片内部设计结构的情况下，在封装环节进一步优化芯片的线路布局，以低成本的方式实现降低芯片导通电阻、提升电性能的效果；锡凸块具有密度大、间距小、低感应、散热能力佳的特点，适用于细微间距的芯片产品，市场空间较大。同时，面对“后摩尔时代”芯片尺寸越来越小、电性能要求越来越高的技术发展趋势，公司建立了 DPS 和载板覆晶封装制程，助力实现更小尺寸和更高集成度的整套封装测试的解决方案。同时，公司依托在金属凸块技术方面的深厚积累，正积极布局“FSM（正面金属化）+BGBM（背面减薄与金属化）+Cu Clip（铜片夹扣键合）”的先进封装组合，建立载板覆晶封装（FC）制程，优化公司产品布局，拓宽功率芯片应用领域。

（二）高质量、高稳定性和高可靠性的产品优势

集成电路产品的可靠性，是企业持续服务客户的基石。公司落实全流程质量管理，把风险预防和过程管控融入研发、生产、检测各个环节；借助产品质量先

期策划、统计过程控制等成熟管控流程，做好各阶段质量节点把控，确保产品质量始终符合客户标准。公司先后通过IATF16949汽车行业质量管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ANSI/ESD S20.20静电防护管理体系等多项国际权威认证。对照外部体系标准搭建内部管理制度，层层筑牢质量防线，持续保障产品品质稳定可靠。

通过多年来精益求精的工匠精神，报告期内公司在凸块制造、COG/COP、COF、DPS等各主要生产环节的生产良率可稳定在99.95%以上。优异的品质管控能力为公司树立了良好口碑，也为公司业务开展奠定了坚实基础。

（三）技术改造与软硬件开发优势

集成电路的先进封装与测试领域涉及的工序较多且技术发展日新月异，需要对生产软硬件进行不断地升级改造以快速响应客户需求。公司一直致力于智能制造的投入与专业人才的培养，拥有一支20余人的专业化团队，具备较强的核心设备改造、配件设计以及自动化系统开发能力。

在核心设备改造方面，公司自主设计并改造了一系列适用于125mm大版面覆晶封装的相关设备，为大版面覆晶封装产品的量产奠定了坚实基础，并自行完成了核心8吋COF设备的技术改造以用于12吋产品，大幅节约了新设备购置所需的时间和成本；在高端设备配件及工治具设计方面，公司研发设计出高温测试治具装置，解决了测试温度均匀性问题，提升了晶圆测试效率和品质；在系统开发方面，自主研发出真空溅镀、电镀等关键节点参数智能化监控系统，并且开发出测试自动化体系，进一步提升了公司整体的工艺管控水平。出众的技术改造与软硬件开发能力是公司自主创新的重要体现。

（四）丰富的产品组合及特色工艺优势

公司可顺应客户要求，提供基于8吋、12吋晶圆的全制程“一站式”封测业务，可极大提高产品的稳定性与可靠性，并有效减轻客户成本。针对电源管理芯片、射频前端芯片等产品对于高I/O数、高电性能、低导通电阻日益增长的需求，公司可提供如铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等先进凸块制造技术以及重布线、多层堆叠等特色工艺，也可提供全制程的Fan-in WLCSP量产服务以满足客户需要。此外，公司还可为客户提供各类配套服务，如凸块制造所需的光罩设计、探

针卡的设计维修、薄膜覆晶卷带设计、测试程式开发等。丰富的产品组合和先进的特色工艺为公司提供了极具市场竞争力的业务基础。

（五）地域优势

公司客户主要为集成电路芯片设计企业，其对交货时间要求严格，交货时间短和便利的地理位置可为集成电路芯片设计企业减少库存，节约运输时间和资金成本，及时应对来自客户的随机性和突发性需求，方便企业与客户交流和反馈，增强其竞争力。

公司注册地合肥市近年来在集成电路领域形成了一定的规模效应，目前已成为中国大陆集成电路产业发展最快、成效最显著的城市之一。合肥市被国家发改委和工信部列为集成电路产业重点发展城市，也是全国首个“海峡两岸集成电路产业合作试验区”和首批“国家集成电路战略性新兴产业集群”。合肥将集成电路产业作为重点发展的战略性新兴产业，构建了从设计、制造、封装测试、装备材料，到公共服务平台的完整产业链生态，已集聚产业链上下游重点企业数百家。晶合集成、京东方、维信诺等与公司相关的上下游企业均在合肥有所布局。

长三角地区是目前中国大陆集成电路产业的主要集群区域，已形成了芯片研发、设计、制造、封装测试以及相关物料和设备等较完整的集成电路产业链。江苏集成电路产业链完备、配套能力强，芯片设计与制造能力提升较快。全资子公司苏州顾中所在的苏州工业园区也汇集了和舰芯片、华星光电等公司上下游企业。

此外，公司在中国台湾设有办事处，可与当地 IC 设计客户保持更为紧密的沟通，有助于公司境外业务的开展。优越的地理位置为公司发展提供了丰沃土壤，有利于公司减少交货时间并节约运输时间、库存成本，同时有助于公司及时处理客户或下游企业的各类需求，方便与其直接交流和反馈，公司在成本控制、人才资源、专业技术上的优势将越发突出。

（六）团队经验丰富、具有创新精神的管理团队

公司的经营管理团队主要成员在集成电路先进封测行业拥有超过 15 年以上的技术研发和生产管理经验，具备国际一流先进封测企业的视野和产业背景。自设立以来，公司经营管理团队通过技术引进、消化吸收和自主创新，逐步积累和

提高了以凸块制造（Bumping）和覆晶封装（FC）为代表的先进封装技术及生产管理的能力。在管理团队的卓越带领之下，公司业务规模不断增长，行业地位显著提升。经验丰富且稳定的管理团队，有利于公司继续保持在行业内的领先地位，不断提升公司品牌效应。

（七）优质的客户资源和市场开发优势

凭借领先的先进封测能力、高品质的产品质量以及多品种的封测服务种类，公司赢得了境内外集成电路设计企业的广泛认可，并与众多国内外知名设计公司保持了良好且稳定的合作关系。在显示驱动芯片封测领域，公司积累了奕斯伟计算、格科微、联咏科技、敦泰电子、奇景光电、瑞鼎科技、谱瑞科技、晶门科技、集创北方、云英谷、通锐微等境内外知名的客户；在多元化芯片封测领域，公司开发了昂瑞微、矽力杰、杰华特、南芯半导体、纳芯微、艾为电子、唯捷创芯、希荻微等优质客户资源。上述客户在集成电路相关领域具有较高的市场占有率和知名度。此外，公司拥有一支在集成电路上下游产业链具有丰富经验和人脉资源的业务团队，有利于公司更好地开拓和服务好客户。优质客户的深度及广度是公司重要的竞争优势。

七、研发支出变化及研发进展

公司始终重视研发体系建设、坚持以市场为导向，与客户紧密合作，坚持对技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障，建立了高素质的管理团队和专业化的核心研发团队。2026年1-6月，公司研发投入7,383.52万元，较上年同期下降20.01%，主要系研发人员股权激励费用减少及公司对技术、工艺等进行持续的开发当期材料投入减少所致。

2026年1-6月，公司获得授权发明专利3项（中国0项，国际3项）、实用新型专利11项、外观设计专利3项。截至2026年6月末，公司累计获得183项授权专利和1项软件著作权，其中183项授权专利包括：发明专利81项（中国62项，国际19项）、实用新型专利98项、外观设计专利4项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）2023 年首次公开发行股份募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 30,223,984.12 元，其中：募集资金理财产品收益 0.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 34,353,621.08 元。使用募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。具体情况如下表：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	242,000.00
减：支付发行有关费用	18,737.38
首次公开发行募集资金净额	223,262.62
减：使用募集资金金额	221,755.84
其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	24,873.31
直接投入募投项目金额	173,619.91
使用超募资金永久补充流动资金金额	13,800.00
使用超募资金回购股份金额	9,462.62
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,435.36
减：利息收入投入募投项目支出	1,919.74
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户应结余额	3,022.40
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	3,022.40
差异金额	0.00

截至 2026 年 6 月 30 日，公司“硕中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”、“硕中先进封装测试生产基地项目”和“硕中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”已达到预定可使用状态，募投项目已结项。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 3,022.40 万元，其中待支付给供应商金额 79.26 万元，预计节余资金 2,943.14 万元，计划用于永久补充流动资金。

（二）2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转换债券实际募集资金专户余额为人民币

333,226,687.85 元，其中：募集资金理财产品收益 0.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 1,897,150.64 元。使用募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	85,000.00
减：支付发行有关费用	1,083.25
可转换公司债券发行募集资金净额	83,916.75
减：使用募集资金金额	50,783.79
其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	8,899.63
直接投入募投项目金额	41,884.16
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	189.72
减：利息收入投入募投项目支出	0.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户应结余额	33,322.67
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	33,322.67
差异金额	0.00

公司 2026 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股情况

1、实际控制人

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、控股股东

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东合肥硕中科技控股有限公司持有公司 397,127,159 股，持股比例为 33.40%。

3、董事和高级管理人员

截至 2026 年 6 月 30 日，公司董事和高级管理人员的持股情况如下：

序号	名称	任职	持股数量 (股)	持股比例
1	陈小蓓	董事长（离任）	-	-
2	傅庶	董事长	-	-
3	赵章华	董事	-	-
4	黄玲	董事	-	-
5	罗世蔚	董事	-	-
6	崔也光	独立董事	-	-
7	王新	独立董事	-	-
8	解光军	独立董事	-	-
9	杨宗铭	董事、总经理、核心技术人员	1,799,867	0.15%
10	余成强	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	614,195	0.05%
11	张玲玲	副总经理	-	-
12	周小青	副总经理	347,656	0.03%
13	朱晓玲	副总经理	-	-
14	王小锋	核心技术人员	165,438	0.01%
15	戴磊	核心技术人员	-	-

注：本表中列示的董事和高级管理人员持股数量为直接持股数量。

（二）质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人和董事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于合肥硕中科技股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

吴建航

吴建航

廖小龙

廖小龙

